

第3回 3次元積層 半導体量子イメージセンサ 研究会

KEK

AIST

東京大学
VDEC

筑波大学

参加費
無料

定員 150 名

2019. 1. 28 (月) 13:30-17:30

会場: つくば国際会議場 (大会議室102室)

招待講演

近接場結合3次元集積技術

慶応大学 黒田 忠広

超短パルスレーザーによる分子振動イメージング

東京大学 小関 泰之

量子線センサー3D化のための μ Bump技術

東北マイクロテック(株) 元吉 真

シリコンとCdTeの異種半導体一体型
3次元X線ピクセル検出器

京都大学 鶴 剛

一般講演

倉知 郁生(KEK) 菊地 克弥(産総研) 山田 美帆(KEK)

詳細・参加申込み

会場準備の都合上、できるだけ事前申込みをお願いします。

詳細はサイトをご覧ください。

http://rd.kek.jp/project/soi/TIA19/1901_TIA3D.html



お問合せ

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構

先端加速器推進部 倉知郁生 mail: kurachii@post.kek.jp

主催: TIA連携プログラム探索推進事業「かけはし」: '3次元積層半導体量子イメージセンサの調査研究'グループ
(高エネルギー加速器研究機構、産業技術総合研究所、東京大学VDEC、筑波大学)

後援: TIA, TIA 光子計測マネジメント・グループ





第3回

3次元積層半導体量子イメージセンサ研究会

program

13:30 はじめに 高エネルギー加速器研究機構 倉知 郁生

一般講演

13:50 3次元集積実装技術の実現に向けた産総研における
研究開発 産業技術総合研究所 菊地 克弥

14:15 3次元積層技術を用いた高エネルギー加速器実験における
次世代ピクセル検出器の研究開発 高エネルギー加速器研究機構 山田 美帆

招待講演

14:35 シリコンと CdTe の異種半導体一体型
3次元 X線ピクセル検出器 京都大学 鶴 剛

14:55 量子線センサー 3D化のための μ Bump 技術
東北マイクロテック (株) 元吉 真

15:30 Coffee Break

15:55 超短パルスレーザーによる分子振動イメージング 東京大学 小関 泰之

16:30 近接場結合 3次元集積技術 慶応義塾大学 黒田 忠広

17:05 ディスカッション 高エネルギー加速器研究機構 倉知 郁生

17:25 まとめ 高エネルギー加速器研究機構 新井 康夫

会場

つくば国際会議場 (エポカルつくば)
〒305-0032 茨城県つくば市竹園 2-20-3
URL : <http://www.epochal.or.jp/>

アクセス

つくばエクスプレス つくば駅より徒歩 10分
会場周辺に有料駐車場あり
<http://www.epochal.or.jp/access/index.html>

